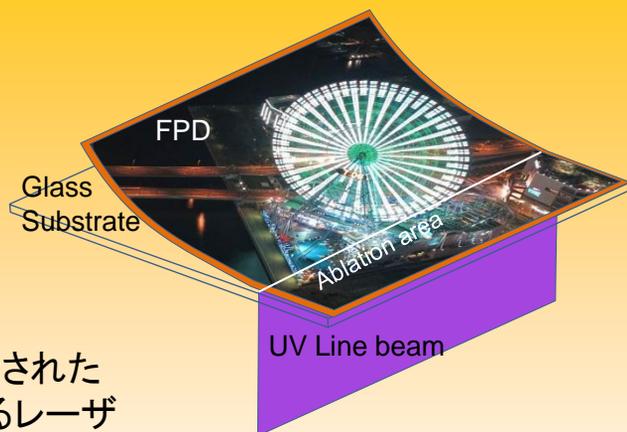


特徴

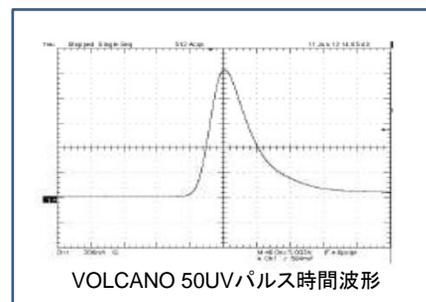
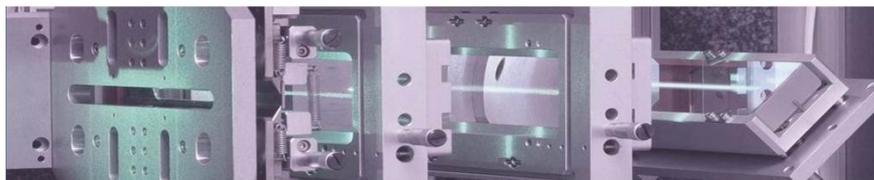
- 大面積LLOプロセス
- 355nm/308nmのタイプ選択



近年フレキシブルのフラットパネルディスプレイや大型ウエハ上での半導体プロセスにおいて製造されたデバイスを基板の裏からレーザーにより剥離させるレーザーリフトオフ・プロセス(LLO)が注目されています。

ガラス基板などレーザーを透過する基板を用いてアブレーション加工出来るものであれば界面に発生する応力より空気中の加工より容易に剥離が可能です。従来のLED製造におけるGaNのリフトオフではダイサイズが比較的小さいく小面積の均一ビームの照射で十分でした。FPD用途では全域をリフトオフする必要がありラインビームプロセスが有効です。

VOLCANO 50UV / LB 365 はFPDボトムの有機膜を高スループットでリフトオフするために必要な紫外ラインビームを提供します。



紫外ラインビームタイプ

VOLCANO 50UV
ライン長さ 50 mm
波長 355nm

VOLCANO LB 365UV
/308nm
ライン長さ365 mm
波長 308nm

